MENU SEARCH INDEX JAPANESE

1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-086572

(43)Date of publication of application: 31.03.1989

(51)Int.Cl.

H01L 33/00

(21)Application number : 62-245218

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

28.09.1987

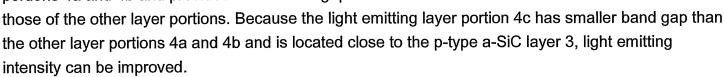
(72)Inventor: NAKADA YUKIHIKO

(54) AMORPHOUS THIN FILM LIGHT EMITTING ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase light emitting intensity by forming an light emitting layer portion, having a band gap smaller than that of a non-light emitting layer portion adjacent to each conductive layer, at that portion of an intrinsie semiconductor layer remote from first and second conductive layers that pinch the semiconductor layer.

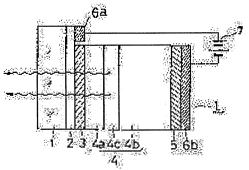
CONSTITUTION: An light emitting element L consists of a transparent conductive layer 2 formed on a glass substrate 1, a p-type a-SiC layer 3 and an Ag electrode 6a formed on the conductive layer 2, a light emitting i-type a-SiC layer 4, n-type a-SiC layer 5 and an Ag electrode 6b formed on the layer 3 in succession. The i-type a-SiC layer 4 includes a light emitting portion 4c formed between two adjacent non-light emitting layer portions 4a and 4b and provided with a band gap smaller than



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]



⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-86572

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)3月31日

H 01 L 33/00

A-7733-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称

アモルファス薄膜発光素子

②特 願 昭62-245218

20出 願 昭62(1987)9月28日

70条明者 中田

行 彦

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑩出 願 人 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

网代 理 人 弁理士 野河 信太郎

明和曹

1. 発明の名称

アモルファス薄膜発光素子

2. 特許請求の範囲

上記兵性半導体層が上記第1および第2導電層にそれぞれ機接する2つの半導体層部分と、この両半導体層部分の間に形成され、それらよりも実質的に狭いパンドギャップを有する半導体層部分とからなるアモルファス機膜発光素子。

3. 発明の詳細な説明

(イ)産菜上の利用分野

本発明は、アモルファス半導体材料を用いた pin 型のアモルファス薄膜発光素子に関するもの である。

(ロ)従来の技術

従来、アモルファスカーボン(以下、 a ーSi Cと称す)を用いてpln 型に形成したアモルファス薄膜発光素子(以下、発光素子と称す)が開発されている。

すなわち、第3図において、発光素子しては、ガラス整板1上に透明導電膜2が形成され、この凹凸状をなした導電模上に P型aーSi C層3 およびAg電極6aが形成され、さらに、P型aーSi C層3上には、原次、i (其性)型aーSi C層4、n型aーSI C層5 およびAg電板6bが形成されている。そして、発光用電源7にて順電圧を印加することによりi型aーSi C層4から発光される。

(ハ)発明が解決しようとする問題点

しかるに、第4図に示すように、真性半導体層であるi型a - Si C層 4 のパンドギャップパターンが偏平であるため、i型a - Si C層 4 内に注入されたキャリヤ、すなわち電子と正孔のうち、再結合せずにそれぞれ他方の電極にまで到達した